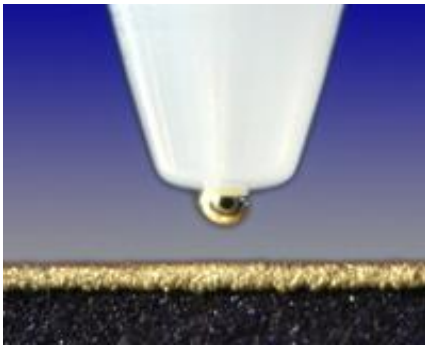


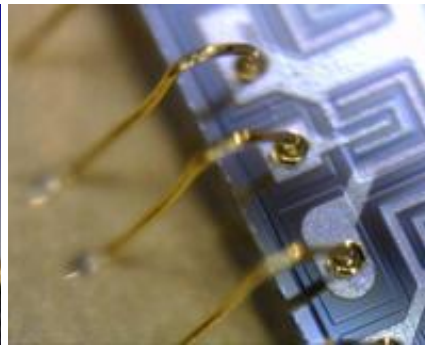
TPT-Applikation Standard 25 μ Gold Ball-Wedge bonden

Material:

- 25 μ Gold Draht, 100m auf 2"-Spule
- Standard 25 μ Kapillare
- Halbautomatischer Ball-Wedge Drahtbonder HB16



Kapillare



Ball-Bond auf Mikrochip



Ball-Bond

Bondprozess:

- Der Draht wird durch die Kapillare gefädelt.
- Die Bondparameter , Ball- Größe, die Bond-Länge und Höhe einstellen.
- Nach dem zweiten Bond schließt die Klammer und der Draht wird abgerissen.
- Das EFO (Electronic Flame EFO) form den Ball.
- Es wird empfohlen die Oberfläche des Substrats auf 120°C zu heizen.

Vorteile gegenüber Wedge-Wedge Bonden:

- Der Erste Bond (Ball) ist fester verbunden.
- Der Ball ist weicher, keine Beschädigungen auf dem Chip.
- Der Draht geht senkrecht nach oben, das ist für große Höhenunterschied gut.
- Gold und Kupfer Draht kann verarbeitet werden.

